



特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 400A以下模块皆为强迫风冷，500A以上模块，既可选择用风冷，也可选用水冷

$I_{F(AV)}$	250A
V_{RRM}	500-2500V
I_{FSM}	11 KA
I^2t	617 $10^3 a^2 s$

典型应用

- 仪器设备的直流电源
- 交直流电机控制，电机软起动
- 各种整流电源
- 电焊机，变频器，电池充放电

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(°C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波，50HZ 单面散热， $T_C=100°C$	150			250	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			393	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	500		2500	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			20	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽，正弦半波	150			11.0	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$				617	A^2S*10^3
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻					0.76	$m\Omega$
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=750A$	25			1.25	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗（结至壳）	180° 正弦波，单面散热				0.140	$°C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗（壳至散）	180° 正弦波，单面散热				0.04	$°C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz,R.M.S,t=1min, $I_{iso}:1mA(max)$		2500			V
F_M	安装扭矩（M5）				12		N-m
	安装扭矩（M6）				6		N-m
T_{stq}	储存温度			-40		125	$°C$
W_t	质量						g
Outline	外形						



Peak forward Voltage Vs. Peak forward Current

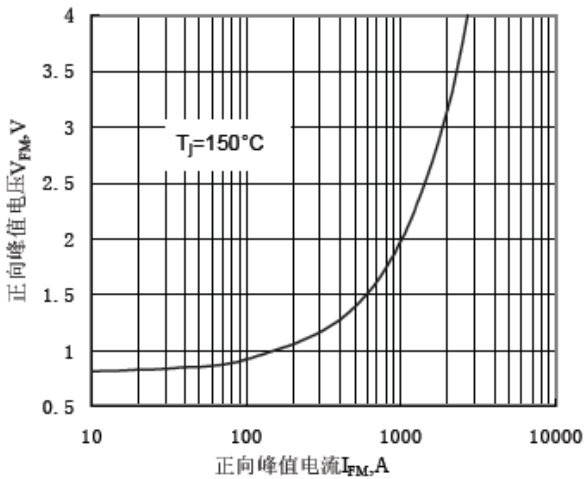


Fig.1 正向伏安特性曲线

Max. junction To case Thermal Impedance Vs. Time

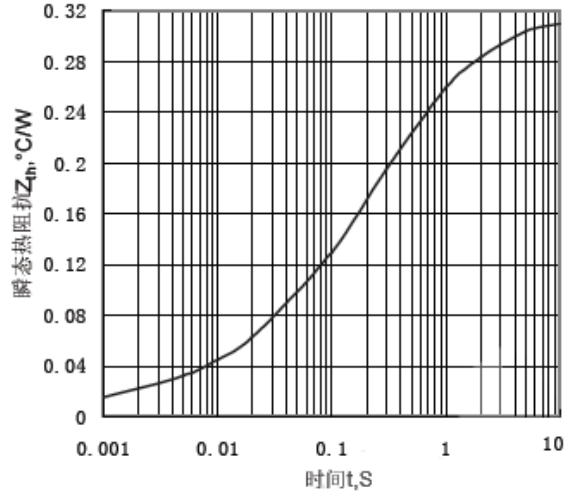


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

Max. Power Dissipation Vs. Mean forward Current

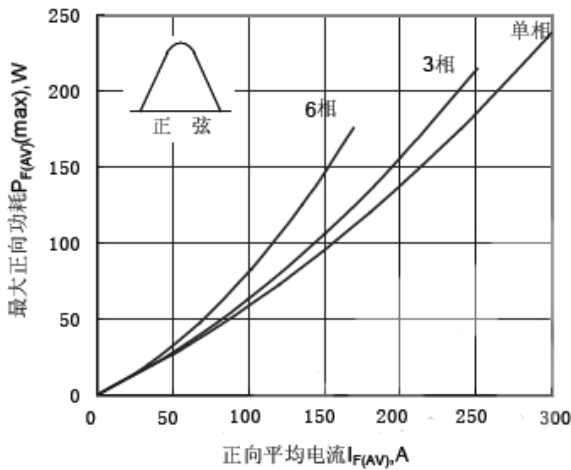


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

Max. Power Dissipation Vs. Mean forward Current

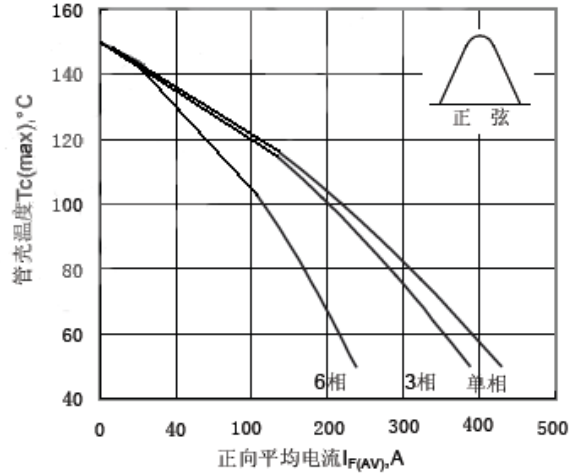


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

Max. case Temperature Vs. Mean forward Current

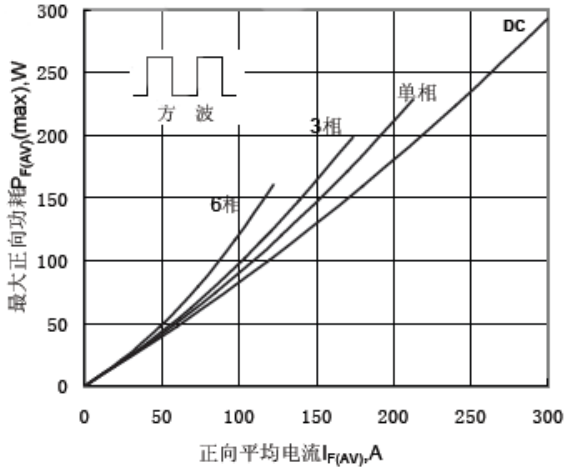


Fig.5 最大正向功耗与平均电流关系曲线

Max. case Temperature Vs. Mean forward Current

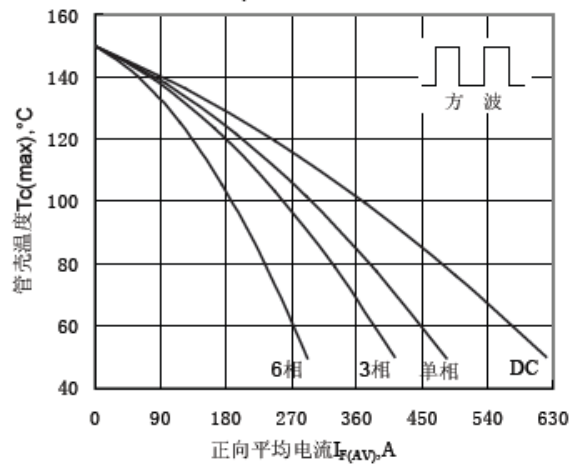


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线

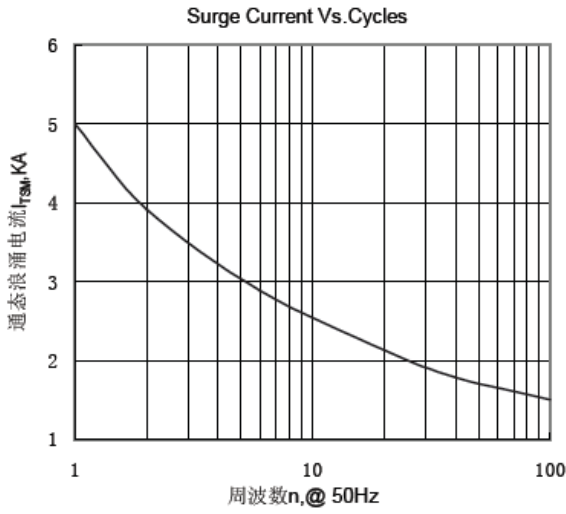


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

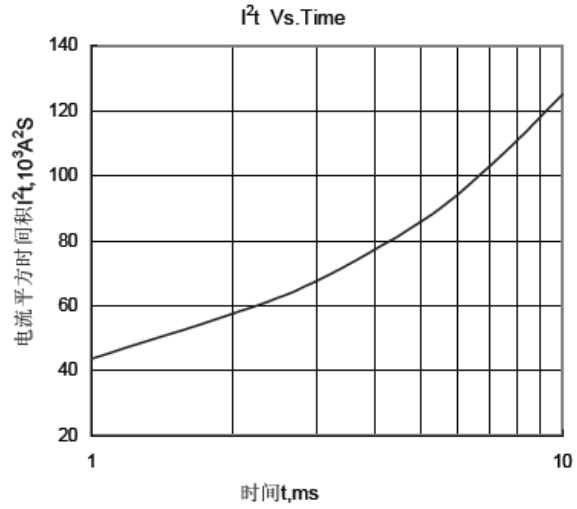


Fig.8 I²t 特性曲线

外形图:

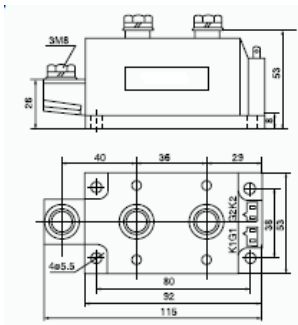


图 1

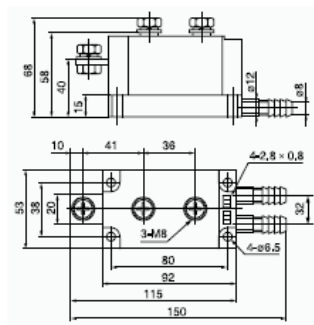


图 2

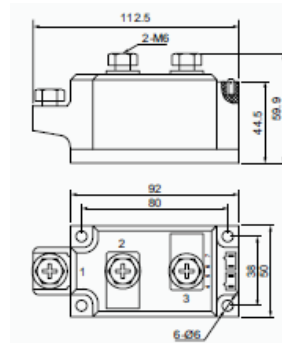


图 3

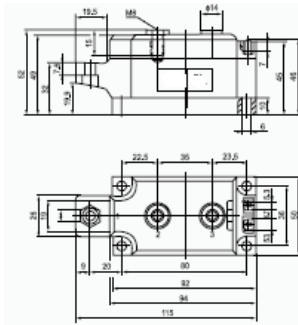


图 4

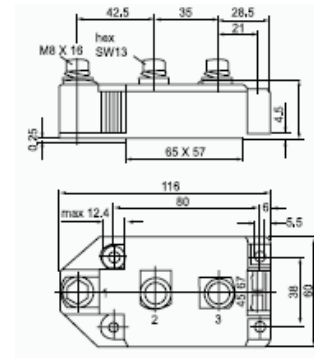


图 5

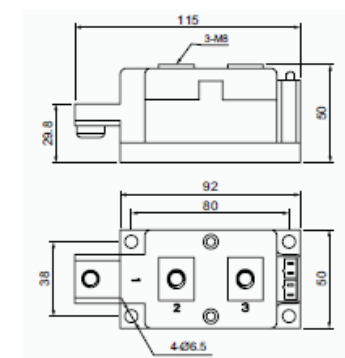


图 6



外形图:

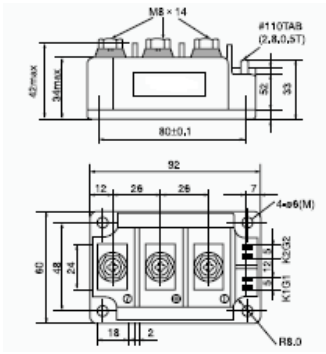
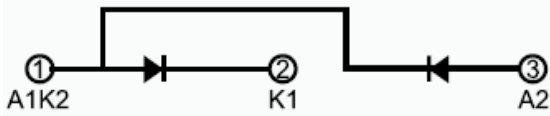


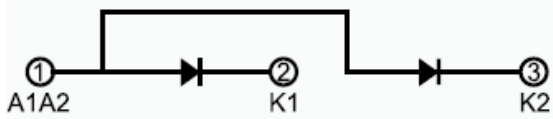
图 5

线路图:

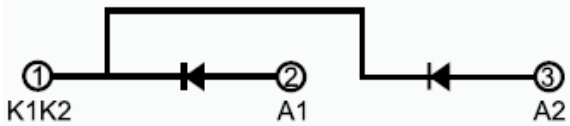
MDC



MDA



MDK



MD

